

2024年3月期

第3四半期 決算説明

2024年2月8日

芝浦メカトロニクス株式会社

3Q累計業績サマリー

* 3Q累計：4月～12月

■ 売上高・利益

- 対前年 増収減益
- 売上高は計画通りに推移し 479億円（SPE が377億円で分野別売上高比率79%）
- 営業利益はSPE分野が堅調で 81.0億円（ROS 16.9%）
- 経常利益は為替の影響により対前年増益し 80.0億円

■ 受注高

- 対前年 21%減少 466億円
半導体分野の後工程では先端パッケージ向けが堅調に推移したが、前工程ではウェーハ向けを中心に一部顧客の設備投資計画の見直しなどにより受注は減少傾向。2024年後半の回復に期待。

■ 受注残高

- 2023年12月末 642億円

■ 23年度業績予想

- 前回予想比 売上・利益を上方修正、期末配当も増配予定

3Q累計業績結果 (対前年) ①

(単位：億円)

	2022						2023			3Q 累計	対前年 増減率
	1Q	2Q	3Q	3Q 累計	4Q	年度	1Q	2Q	3Q		
売上高	138	154	162	455	155	610	143	162	174	479	+5%
営業利益	21.2	24.8	37.2	83.2	25.9	109.1	21.3	28.9	30.8	81.0	-3%
R O S	15.3%	16.1%	23.0%	18.3%	16.7%	17.9%	14.9%	17.8%	17.8%	16.9%	-1.4pt
経常利益	19.1	23.5	35.2	77.8	27.3	105.1	22.1	28.2	29.7	80.0	+3%
当期純利益	16.8	17.4	27.2	61.4	30.6	92.0	18.0	20.7	21.8	60.5	-1%
受注高	289	185	114	589	179	768	177	156	133	466	-21%

3Q累計業績結果（対前年）②

* SPE : 半導体前・後工程装置

FPD : FPD前・後工程装置

- 売上高 前年比 5%増収 (455億円 ⇒ 479億円)
 - SPE分野が増加、FPD分野は減少、全体として増収
- 営業利益 前年比 3%減益 (83.2億円 ⇒ 81.0億円)
 - SPE分野は増益だが、FPD分野が減益で、研究開発強化による販管費の増加などにより、全体として減益
- 経常利益 前年比 3%増益 (77.8億円 ⇒ 80.0億円)
 - 為替の影響により増益
- 受注高 前年比 21%減少 (589億円 ⇒ 466億円)
 - 顧客の設備投資計画の見直しなどにより減少

セグメント別 3Q累計業績結果 (対前年) ①

■ ファインメカトロニクス部門

* ファインメカトロニクス部門：半導体/FPD前工程装置

➤ 売上高 前年比 14%増 (312億円 ⇒ 356億円)

半導体前工程では、ロジック/ファウンドリ向けやウェーハ向けがいずれも順調で増加。
FPD前工程では、低調で減少。

➤ セグメント利益 前年比 5%増 (69.2億円 ⇒ 72.9億円)

半導体前工程の売上増加により増益。

➤ 受注高 前年比 36%減 (448億円 ⇒ 288億円)

半導体前工程では、ロジック/ファウンドリ向け及びマスク向けを中心に堅調に推移したが、ウェーハ向けを中心に一部顧客の設備投資計画の見直しなどにより減少。
FPD前工程では、市況の影響を受け低調に推移。

セグメント別 3Q累計業績結果 (対前年) ②

■ メカトロニクスシステム部門

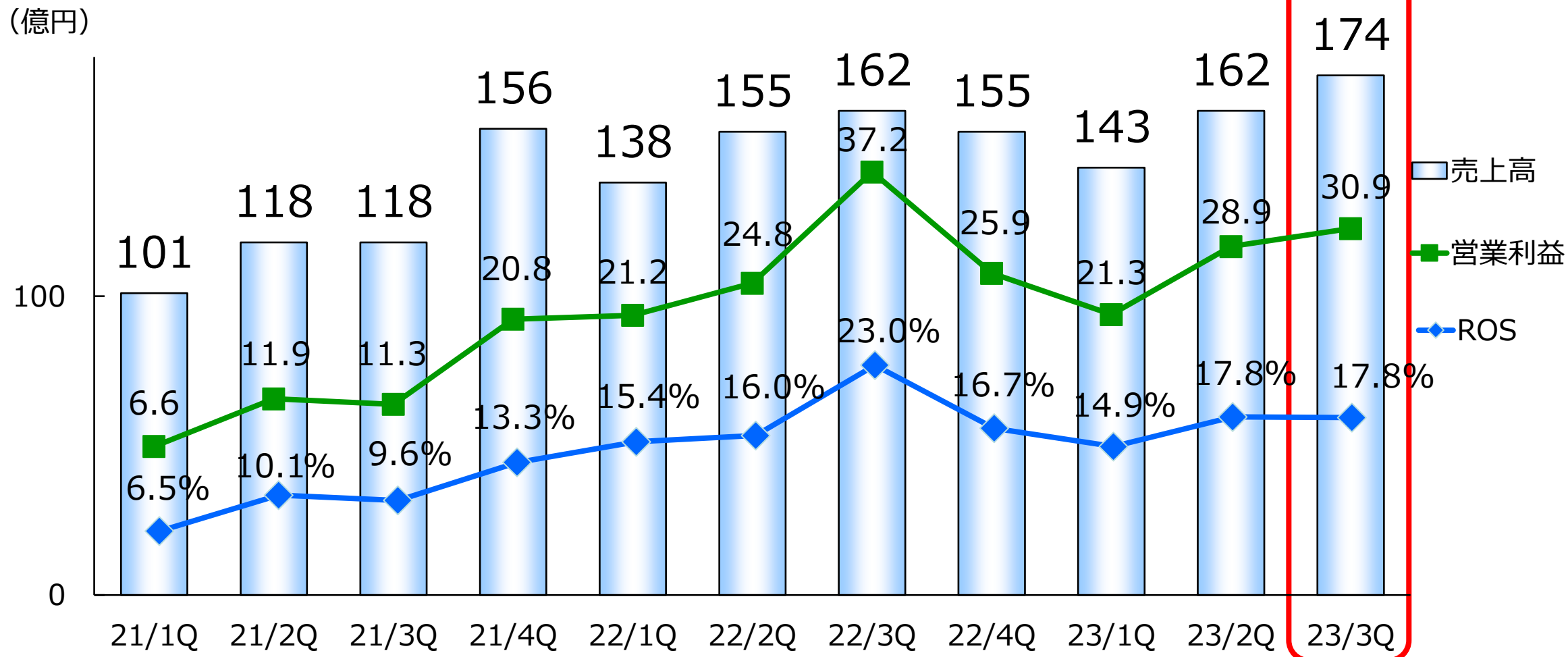
*メカトロニクスシステム部門：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

- **売上高** 前年比 21%減 (112億円 ⇒ 88億円)
全体として、3Q累計で減少だが前2Q比増加。特に半導体後工程が大幅増加。
半導体後工程では、先端パッケージ向けが堅調で増加。
FPD後工程では、前年度受注低調の影響により減少。
真空部門では、半導体向けが堅調で増加。
- **セグメント利益** 前年比 36%減 (15.9億円 ⇒ 10.2億円)
半導体後工程は売上増加だが、FPD後工程の売上減少により減益。
- **受注高** 前年比 20%増 (110億円 ⇒ 131億円)
半導体後工程では、先端パッケージボンダの需要増に伴い増加。
FPD後工程では、市況の影響を受け大幅に減少。
真空部門では、半導体向けを中心に順調に推移。

売上高・利益・ROS

ROS17.8%

(億円)

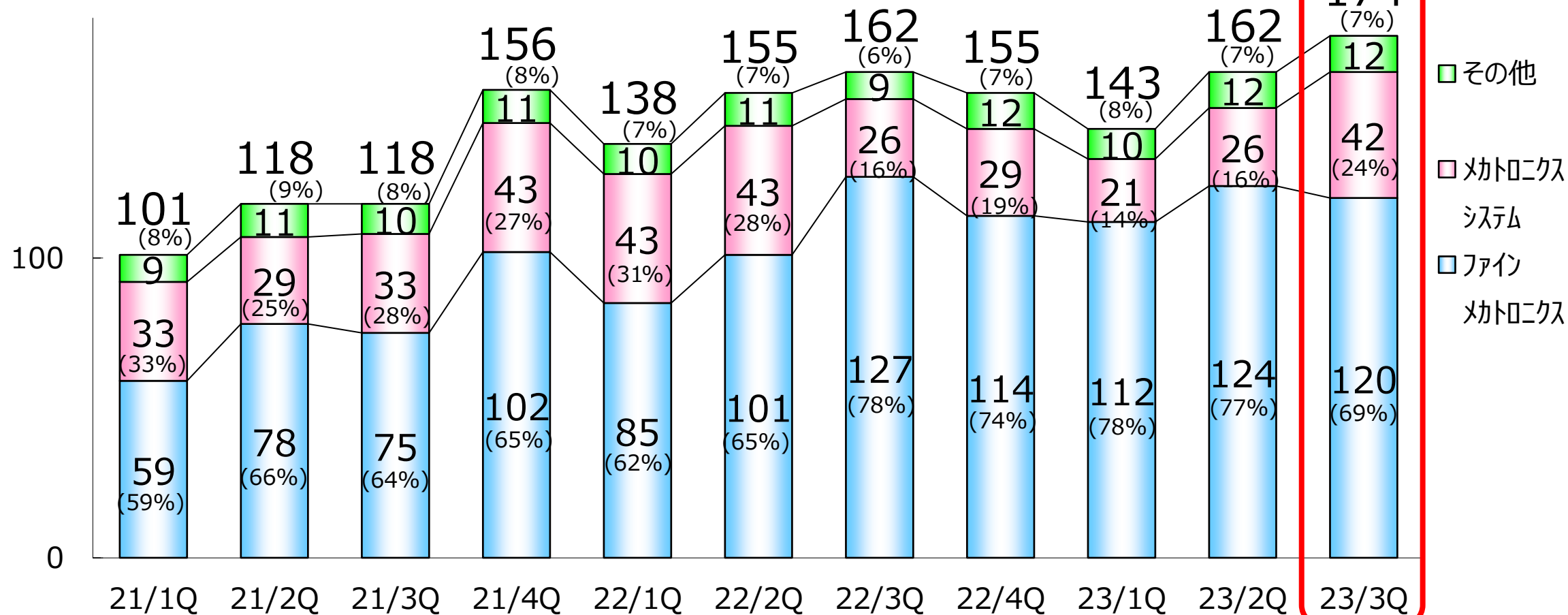


セグメント別売上高

ファインメカトロニクス 69%
メカトロニクスシステム 24%

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

(億円)

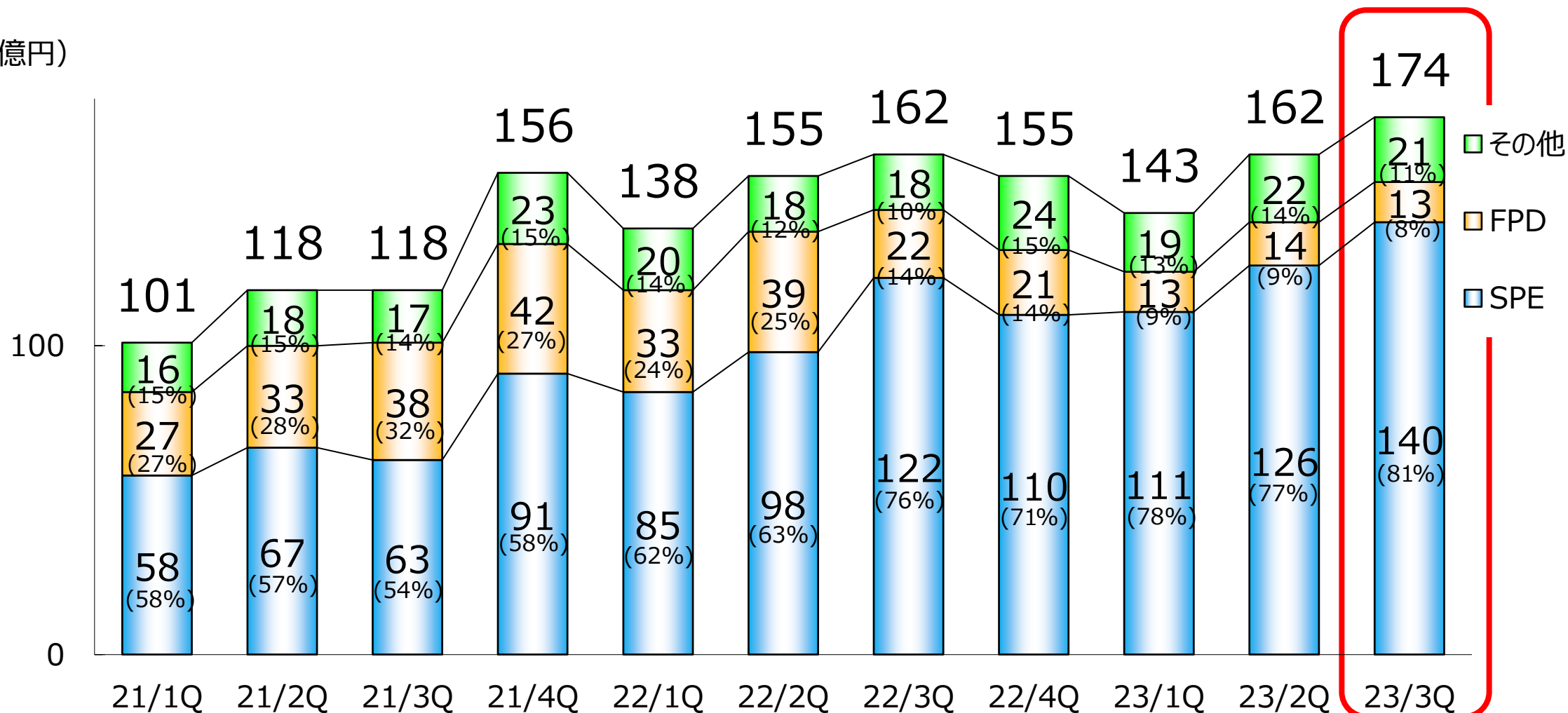


分野別売上高

SPE分野 81%

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

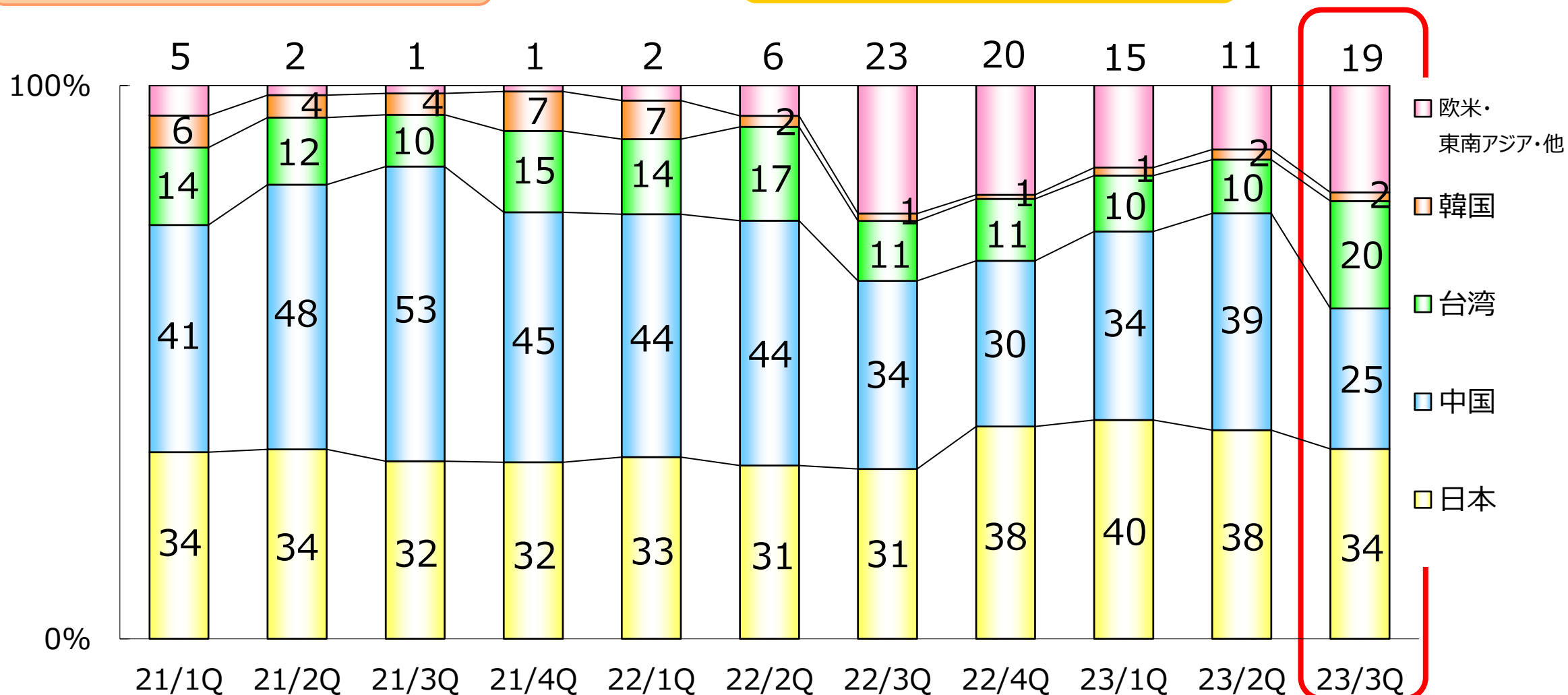
(億円)



地域別売上高比率

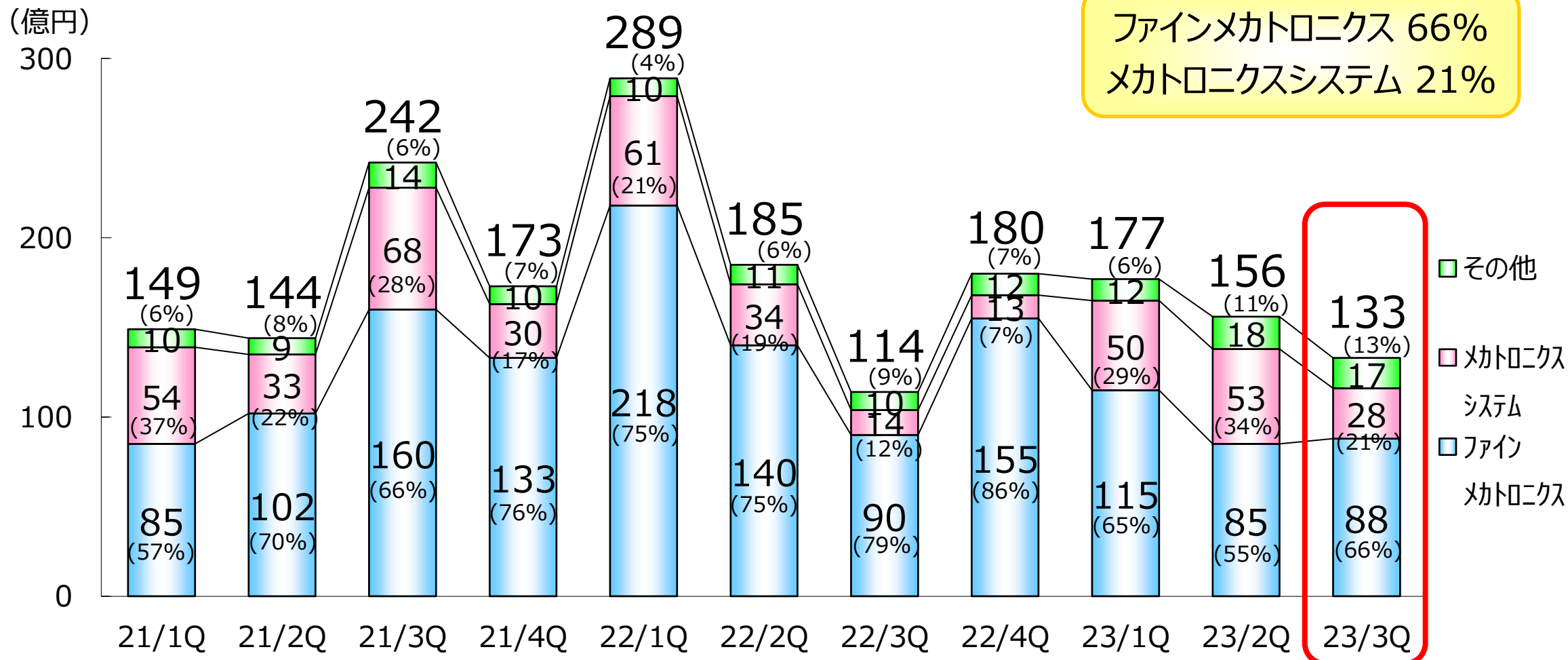
海外向け66% (中国25%)

* 仕向地で区分



セグメント別受注高

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

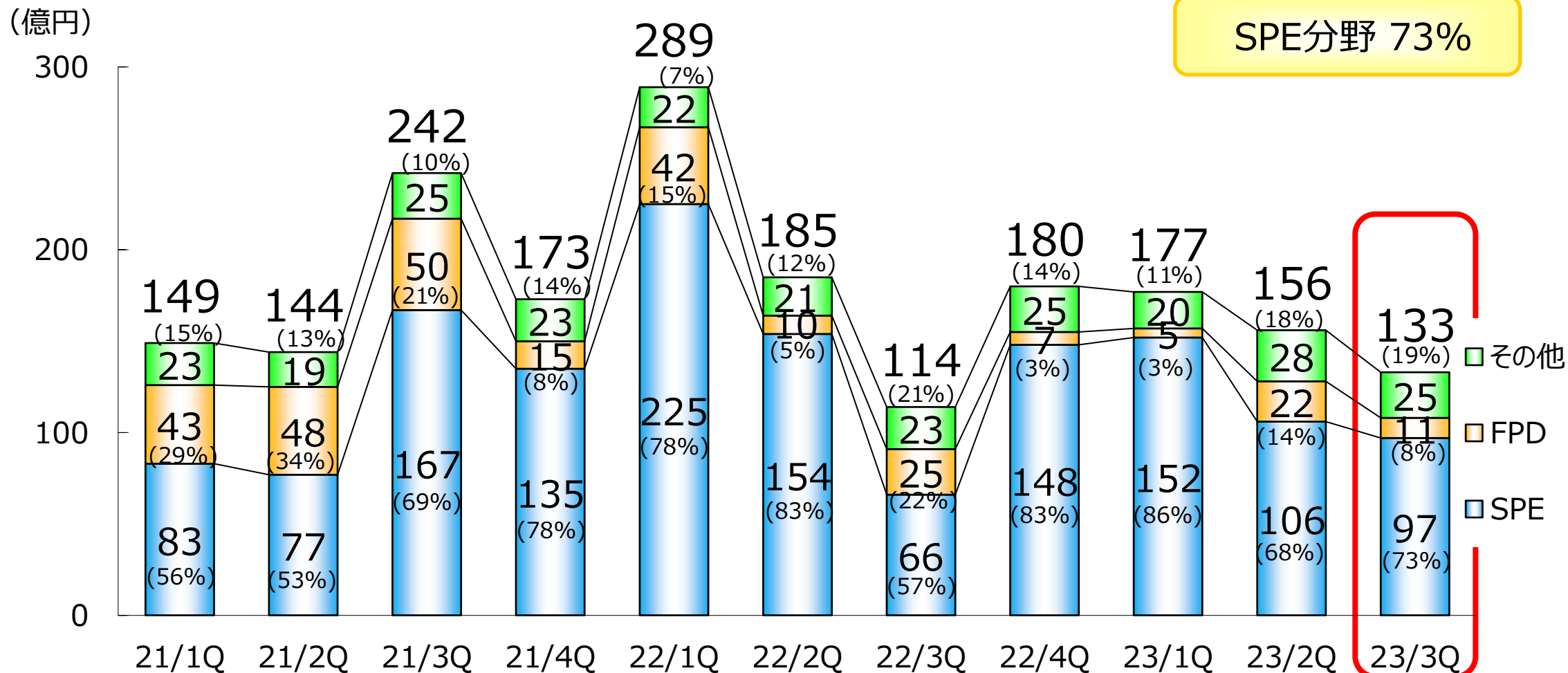


ファインメカトロニクス 66%
メカトロニクスシステム 21%

■ その他
■ メカトロニクス
■ システム
■ ファイン
メカトロニクス

分野別受注高

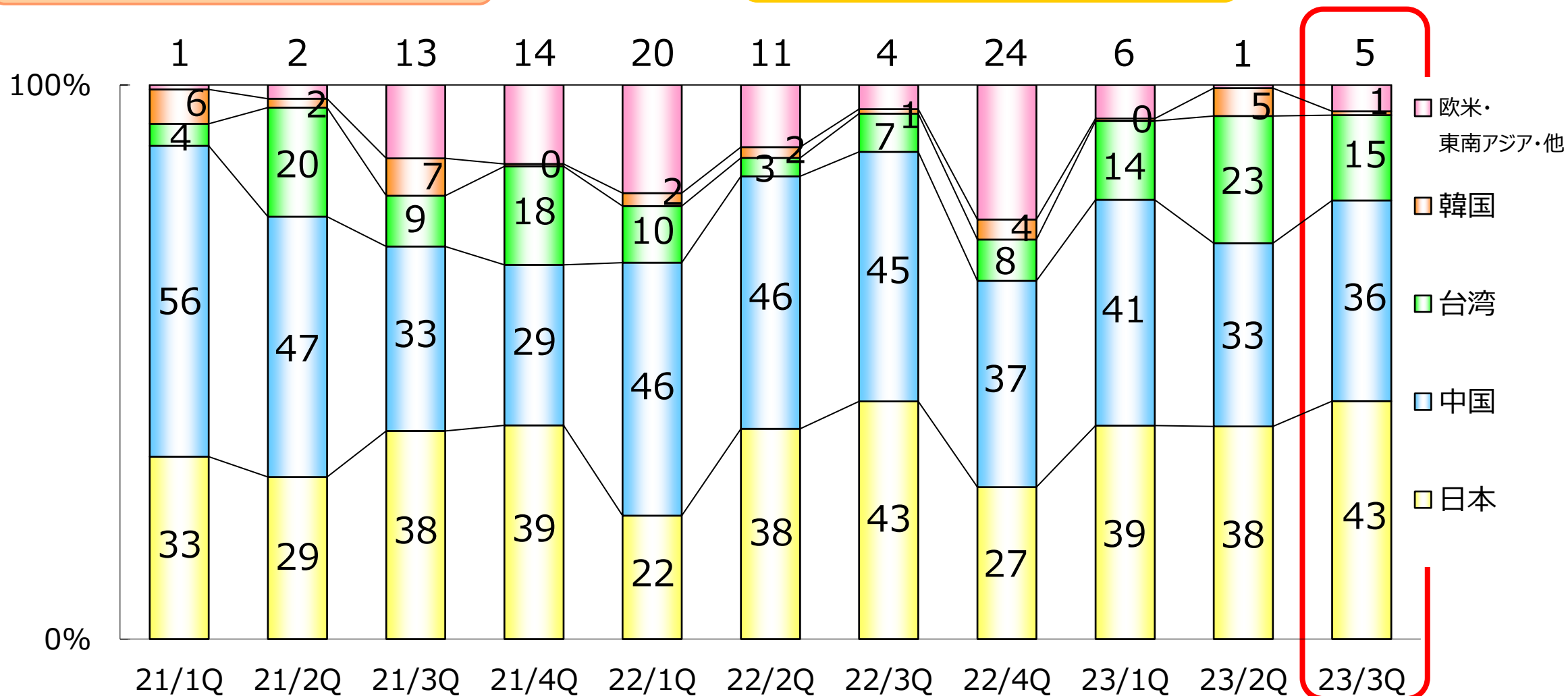
* SPE : 半導体前・後工程装置
 FPD : FPD前・後工程装置



地域別受注高比率

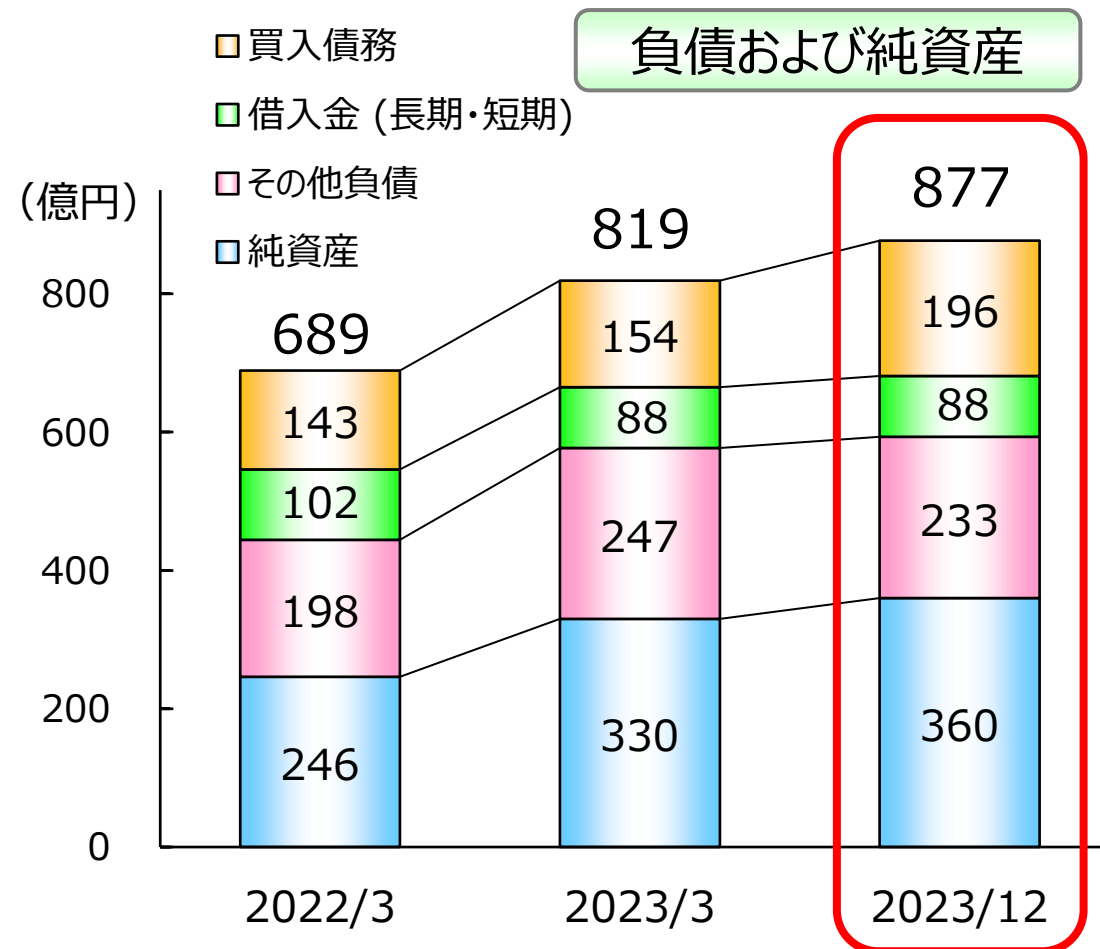
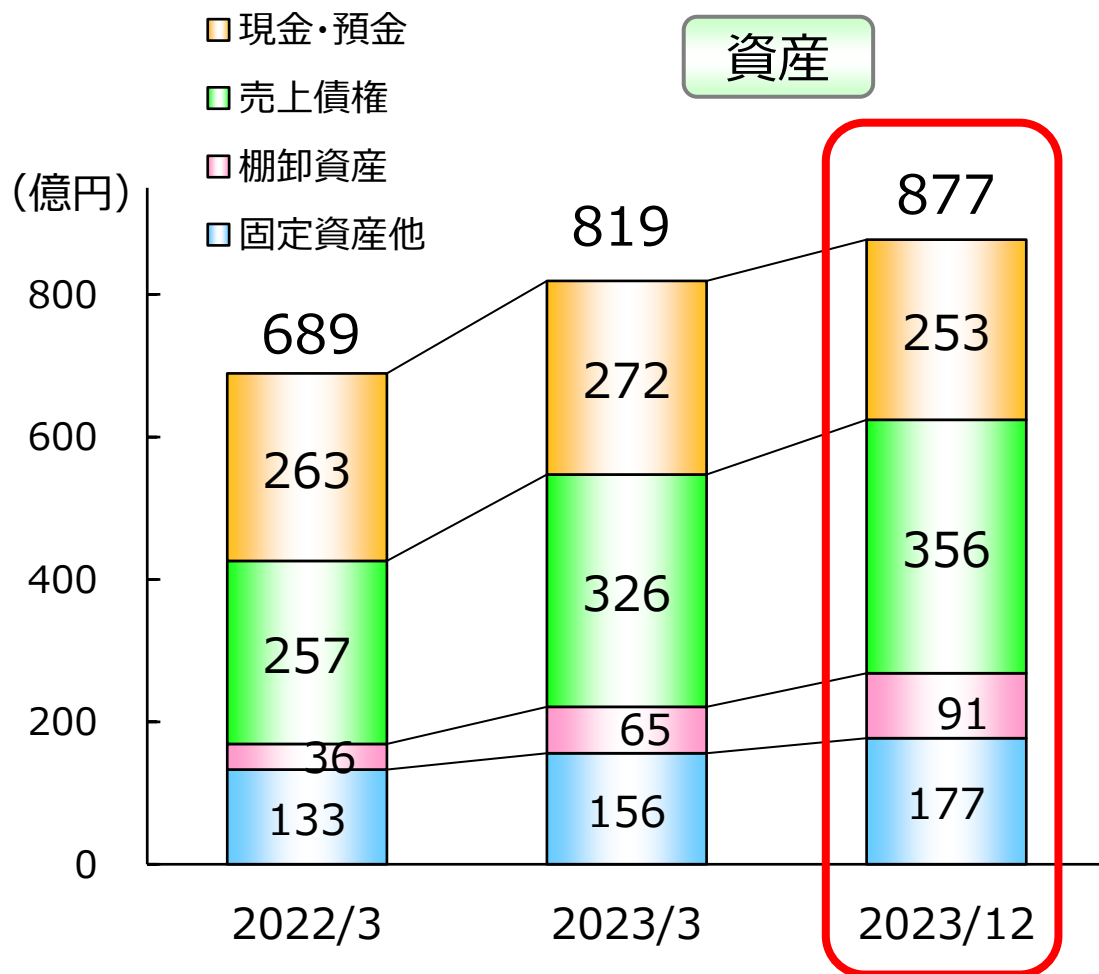
海外向け57% (中国36%)

* 仕向地で区分



貸借対照表

自己資本比率 40% ('23/3) → 41% ('23/12)
 D/Eレシオ 0.27倍 ('23/3) → 0.24倍 ('23/12)



2023年度 業績予想 (1)

業績予想

前回予想から売上高、利益とも
上回る見込み

*1: 2023年5月公表
*2: 2023年11月公表
(単位: 億円)

	2020 年度	2021 年度						2023 年度 予想	前回予想 *2 2023 年度	期初予想 *1 2023 年度
			22/3Q 累計	22/4Q	2022 年度	23/3Q 累計実績	23/4Q 予想			
売上高	448	493	455	155	610	479	181	660	650	590
営業利益	29.6	50.5	83.2	25.9	109.1	81.0	24.0	105.0	100.0	73.0
R O S	6.6%	10.3%	18.3%	16.7%	17.9%	16.9%	13.2%	15.9%	15.4%	12.4%
経常利益	28.2	48.8	77.8	27.3	105.1	80.0	20.0	100.0	97.0	67.0
当期純利益	19.7	29.8	61.4	30.6	92.0	60.5	14.0	74.5	72.0	52.0
R O E	9.5%	12.8%	-	-	31.9%	-	-	21.0%	20.5%	15.0%
配当	110円	230円	-	-	560円	-	-	※ 170円	※ 165円	※ 120円

※2023年10月1日を効力発生日として1株につき3株の割合で株式分割を実施後の金額

配当予想

当社は、連結配当性向をおおむね30%を目途としています。
 2023年度 業績予想の上方修正に伴い、期末配当は5円増配の
170円 (配当性向 30.0%) を予定しています。

	第2四半期末 配当	期末配当	年間配当
今回予想 (2024年3月期)	0円	170円	170円
前回予想 (2024年3月期)	0円	165円	165円

※2023年10月1日を効力発生日として1株につき3株の割合で株式分割を実施後の金額
 株式分割前の算定では配当510円に相当

SPE

* GNT : 現中期経営計画
グローバル ニッチトップ
対象製品群

- グローバルニッチトップ対象製品群の売上堅調
SPE売上高 140億円の内、GNT 100億円（71%）で推移
- 枚葉式Siウェーハ洗浄装置は、全体的に調整局面にあるが一定の引合い継続中
- 枚葉式リン酸エッチング装置は、顧客層及び用途拡大し受注堅調
- マスクエッチング装置は、新規顧客からの引合い増加
- 先端パッケージ用途は受注堅調

FPD

- LCDパネル向けは前・後工程とも、依然として設備投資が低水準
- OLEDパネル向け投資の回復に期待、マイクロOLED、マイクロLED市場に向けても注力

Smart Solutions & Services for Your Manufacturing

「Smart」「Solutions」「Services」の3つの「S」で
お客様のものづくりに貢献してまいります。

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承願います。

END